

超短パルスレーザー加工ユニット

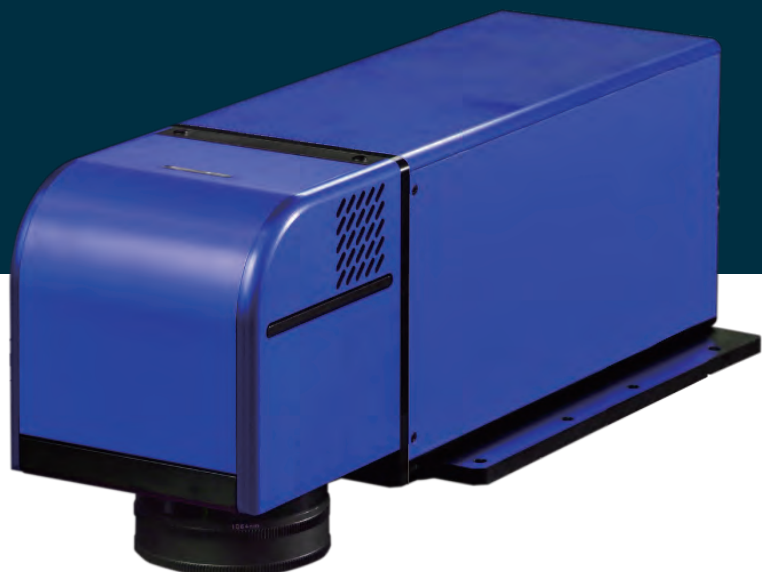
TLFD-100P

TAK
TAKEI QUALITY

加工時の熱影響が小さい

本格ファイバーレーザー

ピコ秒 × 100W



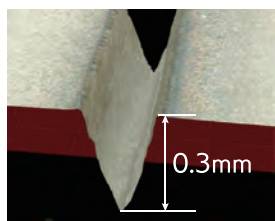
オールインワンの手軽さ
約 100W の高出力
熱影響を抑えたピコ秒レーザー



ガラス切断・表面加工
厚み 0.8mm



セラミックス切断・表面加工
厚み 0.7mm



セラミックス スクライブ



ガラス マーキング

- セラミックス、金属箔、ガラス、樹脂などへの精密加工が可能
- ピコ秒レーザーで加工時の熱影響を抑制
- 高出力 100W の絶対的な加工能力
- デジタルエンコーダによる 1μm 以下の位置再現性